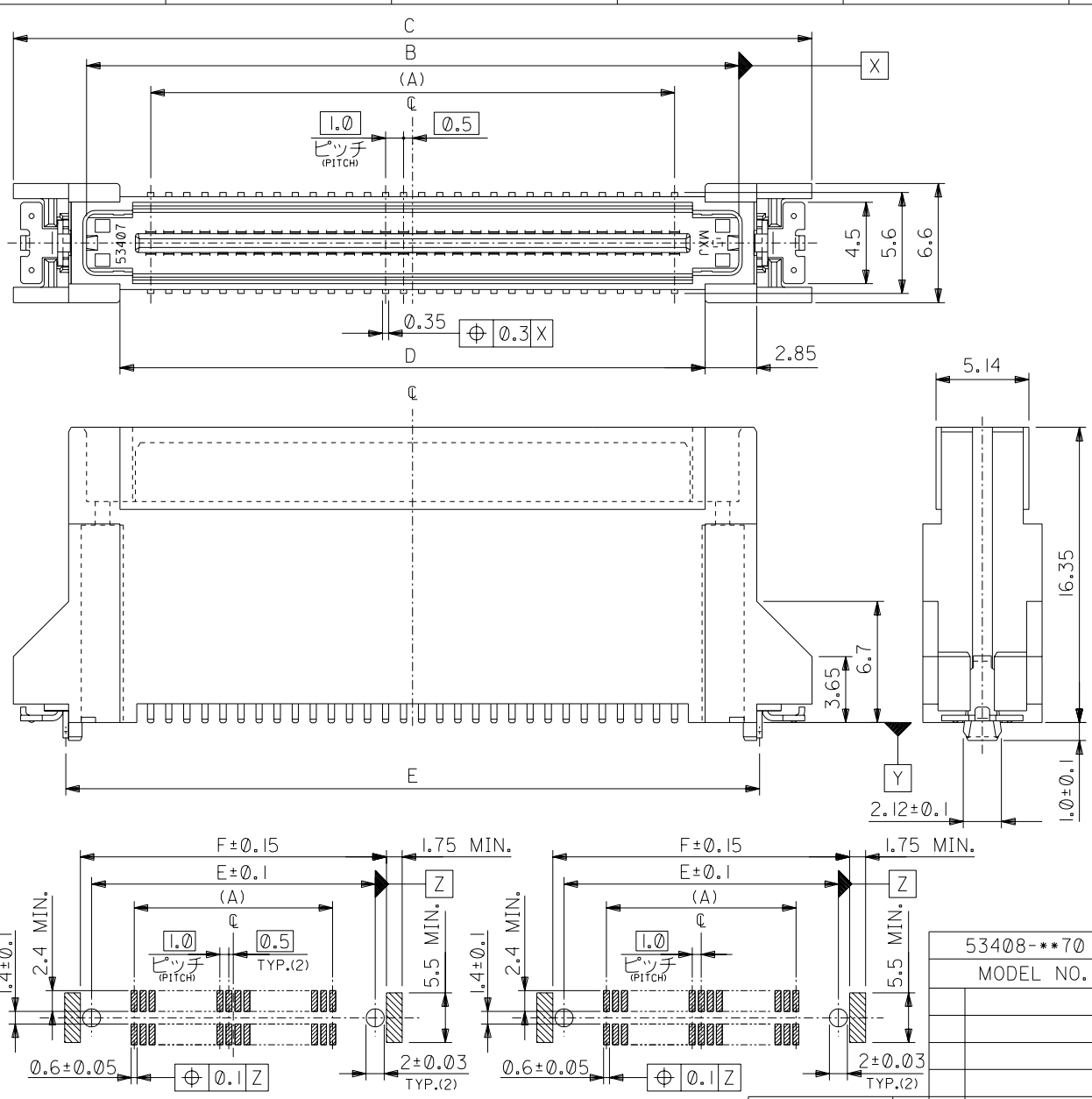


DWG. NO. SD-53408-007

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

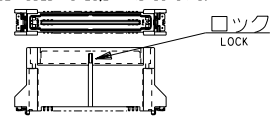


推奨基板寸法 (20, 24, 60, 80, 100, 120, 140極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (20, 24, 60, 80, 100, 120, 140CKTS.)

推奨基板寸法 (50極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (50 CKTS.)

8. 本製品は 53408-***0 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53408-***0

- 注) NOTES
- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入り LCP、白色、UL94V-0
HOUSING: F.LCP, WHITE, UL94V-0
ターミナル: 燐青銅 (t=0.2)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
金属ペグ: 燐青銅
METAL PEG: PHOSPHOR BRONZE
 - メッキ仕様 PLATING
ターミナル 接点部: 金メッキ 0.25 MICROMETER MIN.
TERMINAL CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MIN.
半田付け部: 錫メッキ 1.0 MICROMETER MIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN 1.0 MICROMETER MIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 2.0 MICROMETER MIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 2.0 MICROMETER MIN.
金属ペグ 半田付け部: 錫メッキ 1.0 MICROMETER MIN.
METAL PEG SOLDER TAIL AREA: TIN 1.0 MICROMETER MIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0 MICROMETER MIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MIN.
 - 推奨基板厚 RECOMMENDED PCB THICKNESS
1.0±0.1mm
 - テールのバラツキ寸法 TAIL COPLANARITY
テールは、Y面を基準とし、上へ 0.02 下へ 0.15 の範囲に
めし、且つテール平坦度は 0.15 とする。
TAILS TO BE WITHIN 0.02 UPWARD AND 0.15 DOWNWARD FROM Y-DATUM PLANE,
AND TAIL COPLANARITY TO BE 0.15.
 - ロックは、20、24、50極に設置する。
LOCK TO BE ADDED TO 20, 24 AND 50 CKTS.
 - 梱包 PACKAGING
本製品はスティック梱包とし、梱包後の MATERIAL NO. は
53408-***79 とする。
THIS PRODUCTS TO BE PACKED IN TUBE. MATERIAL NO.: 53408-***79
 - 同一基板内に複数個 (2個以上) の使用は避けてください。
MXJ DOES NOT RECOMMEND THE USAGE OF TWO OR MORE OF THESE CONNECTORS
BETWEEN A SINGLE PAIR OF P.C.B.OARD.



80.9	78.4	72.4	84.2	76.02	69	53408-1470	140	
70.9	68.4	62.4	74.2	66.02	59	53408-1270	120	
60.9	58.4	52.4	64.2	56.02	49	53408-1070	100	
50.9	48.4	42.4	54.2	46.02	39	53408-0870	80	
40.9	38.4	32.4	44.2	36.02	29	53408-0670	60	
35.9	33.4	27.4	39.2	31.02	24	53408-0570	50	
22.9	20.4	14.4	26.2	18.02	11	53408-2470	24	
53408-***70	20.9	18.4	12.4	24.2	16.02	9	53408-0270	20
MODEL NO.	F	E	D	C	B	(A)	MATERIAL NO.	極数 NO. OF CKTS.

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	+0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	+0.25
10 未満 UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —
被覆外径 INS. RANGE	— # —
DRAWN BY	04/03/11 M.NINOMIYA
CHK'D BY	04/03/11 K.TOJO
APP'D BY	04/03/11 M.SASAO
DR. CHK.	
日付 DATE	
変更内容 REVISION RECORD	
新規作成 RELEASED	(J2004-3029)

MOLEX	MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 1.0 B-T0-B S/T PLUG HS'G ASS'Y -LEAD FREE-	
DWG. NO.	SD-53408-007
REV	0